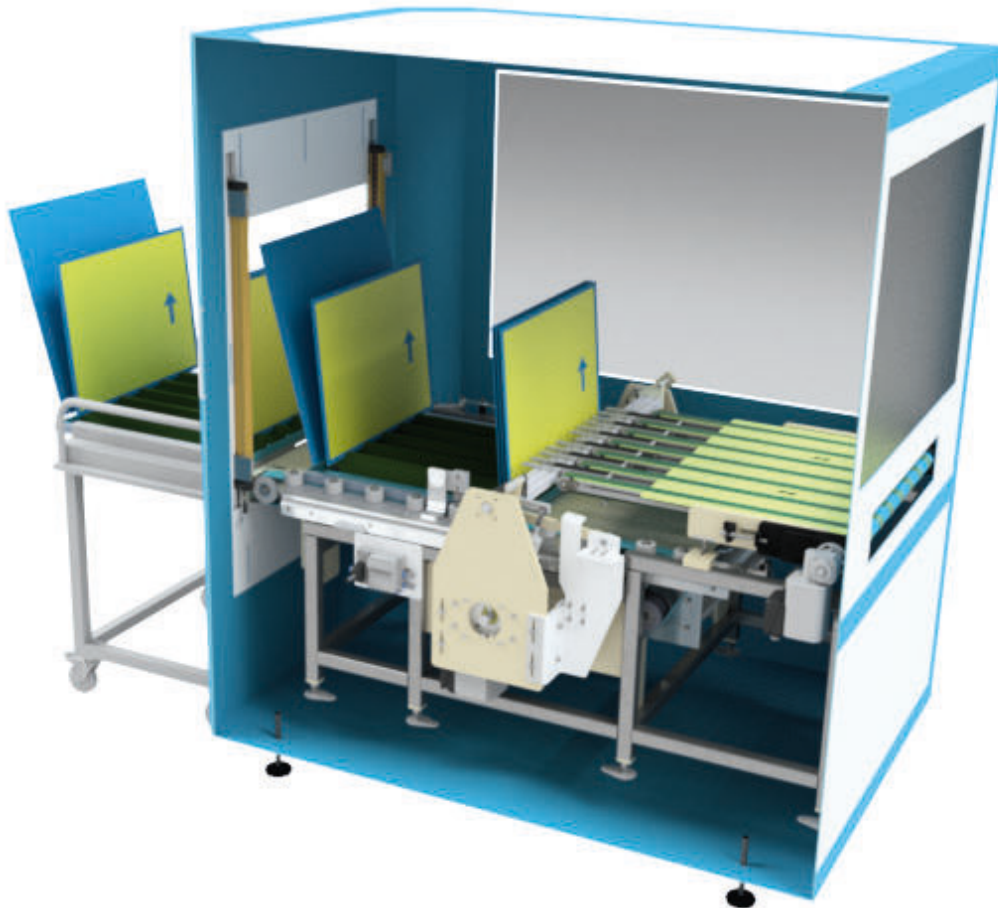


Schlitzbrett Automation SC



Schlitzbrett-Automation SC

Wurde speziell für das Be- und Entladen von Leiterplatten im Soldermask Bereich entwickelt. Die Schlitzbretter werden über Fahrwagen der Anlage zugeführt und genau positioniert. Die Leiterplatten werden beim Belader dann von unten im Randbereich geklemmt, aus den Schlitzen ausgehoben, geschwenkt und auf das Beladeband abgelegt. Beim Entlader werden die Leiterplatten in der Endposition des Auslaufbandes wiederum geklemmt, geschwenkt

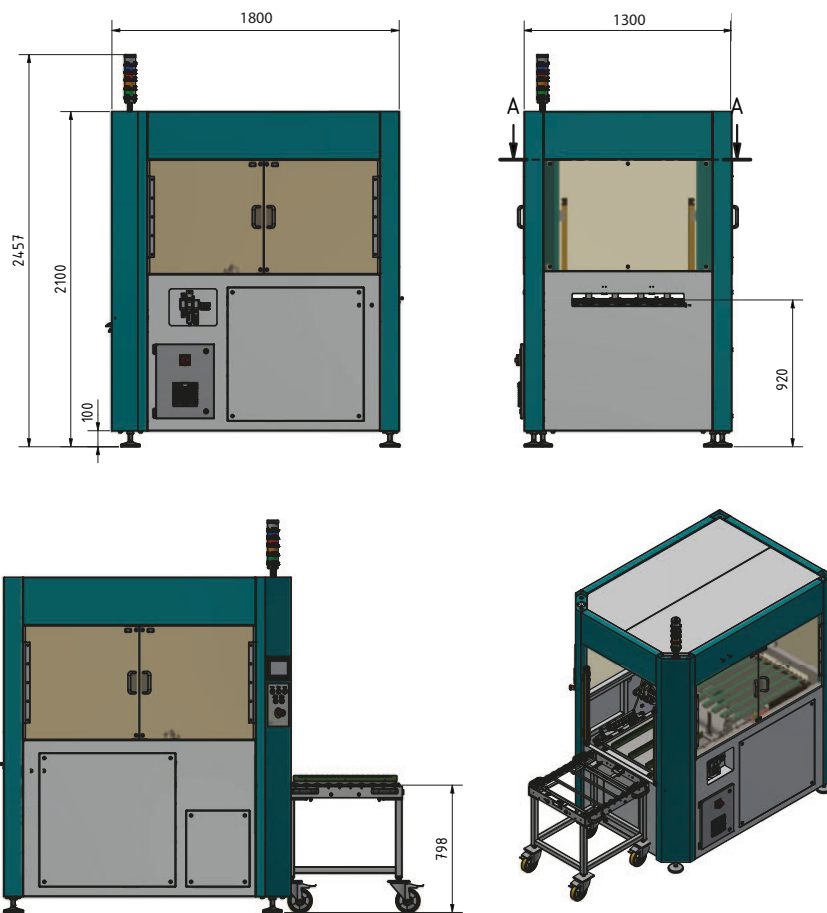
und in die Schlitze des Schlitzbretts abgesetzt. Nach jedem Belade- bzw. Entladevorgang werden die Schlitzbretter automatisch um eine Position, in Durchlaufrichtung gesehen, nach vorne bzw. nach hinten getaktet. Die Schlitzbretter sind in verschiedenen Schlitzbreiten, entsprechend der Leiterplattendicke verfügbar. Optional können die Automationssysteme mit Schlitzbrettwechsel- und zusätzlichen Schlitzbrettspeicher-Stationen ausgerüstet werden.

Schlitzbrett-Automatation SC

HIGHLIGHTS

- Alarm- und Event Logging
- Signalaustausch zwischen Be- und Entladung
- Kapazität bis zu 3-4 Leiterplatten/min
- DMC-Reader und Auftrags-Tracking verfügbar*
- Schnittstelle zu kundenseitigem MES oder Datenbanken*
- Schlitzbretter für unterschiedlichen Leiterplattendicken verfügbar*
 - Typ A: 0,8 - 2,2mm
 - Typ B: 2,2 - 3,2mm
 - Typ C: 3,2 - 4,8mm

*Optional



Technische Spezifikationen

Panelabmessung: Min. 220 x 300mm,
Max. 630 x 630mm
bei starren Leiterplatten

Paneldicke: 0,8 - 4,8mm

Elektrischer Anschluss: 230V 50/60Hz, L/N/PE, ca.1,2kW

Luftanschluß: 6 bar - 2 NL/min

Abmessung (LxBxH): 1800mm (+Wagen 720mm) x
1300mm x2100mm (+Ampel 360mm)

Arbeitshöhe: 920mm -40mm, + 50mm